

2011年3月期 第3四半期決算概要

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2011年1月28日

取締役執行役員常務 小倉 和明

© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

00000-A

本日はご多忙のところお集まりいただき、ありがとうございます。

2011年3月期第3四半期の決算概要について
ご説明いたします。

(本プレゼンテーションに関する注意)

本資料における前連結会計年度(2010年3月期)の業績数値は、旧NECエレクトロニクス(株)と旧(株)ルネサス テクノロジーの前連結会計年度の業績数値を単純合算したものです。なお、「売上高」および「半導体売上高」については、旧NECエレクトロニクス(株)の表示方法と整合させるために旧(株)ルネサス テクノロジーについて一部組替表示しております。

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略および業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与える重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

エグゼクティブサマリー

- **第3四半期は、原価率改善および統合シナジー・製品ポートフォリオの見直しによる研究開発費効率化により営業損益は増益。**
- **通期で70億円の営業利益の達成を目指す。**

こちらが本日のご説明内容のサマリでございます。

まず、2011年3月期 第3四半期の業績につきましては、
第2四半期と比べて、売上高は下回ったものの、
営業損益は、原価率の改善および統合シナジーや製品ポートフォリオの見直しによる
研究開発費の効率化により、増益となりました。

また、2011年3月期通期の見通しにつきましては、期初に掲げました
70億円の営業黒字の目標を維持いたします。

I. 2011年3月期 第3四半期決算概要

4

© 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

それでは、スライドに沿ってご説明してまいります。

2011年3月期第3四半期 決算概要でございます。

2011年3月期 第3四半期(10-12月期)決算概要

- 第3四半期の売上高は、前四半期比7%減収
- 営業損益は、原価率の改善や研究開発費の効率化により増益

(単位:億円)	2011年3月期		
	第3四半期	第2四半期	前四半期比
売上高	2,752	2,954	△203
半導体売上高	2,444	2,635	△191
営業損益	34	11	+23
経常損益	11	△43	+53
当期純損益	△176	△82	△94
1US\$=	83円	88円	5円高
1ユーロ=	112円	111円	1円安

まず、実績のサマリでございます。

第3四半期の半導体売上高は、前四半期との比較で
191億円減収の2,444億円となりました。

営業利益は34億円で、前四半期比では23億円の改善となりました。

経常利益は11億円、
当期純損益は、特別損失として170億円計上したことなどにより
176億円の損失となりました。

2011年3月期 第3四半期半導体売上高(前四半期比)

■ 海外市場は堅調だったものの、国内市場における民生機器などの需要が減少し、アナログ&パワー半導体とSoCが減収

(単位:億円)	2011年3月期		
	第3四半期	第2四半期	前四半期比(%)
半導体売上高	2,444	2,635	△7%
マイコン	939	959	△2%
アナログ&パワー半導体	730	835	△13%
SoC	761	832	△9%
その他半導体	15	9	

6ページは第3四半期の事業別の半導体売上高についてお示ししています。

第2四半期と比較すると、第3四半期の半導体売上高は7%の減収となりました。

製品群別に見ますと、

マイコンは、自動車向け、汎用向けともに微減となりました。

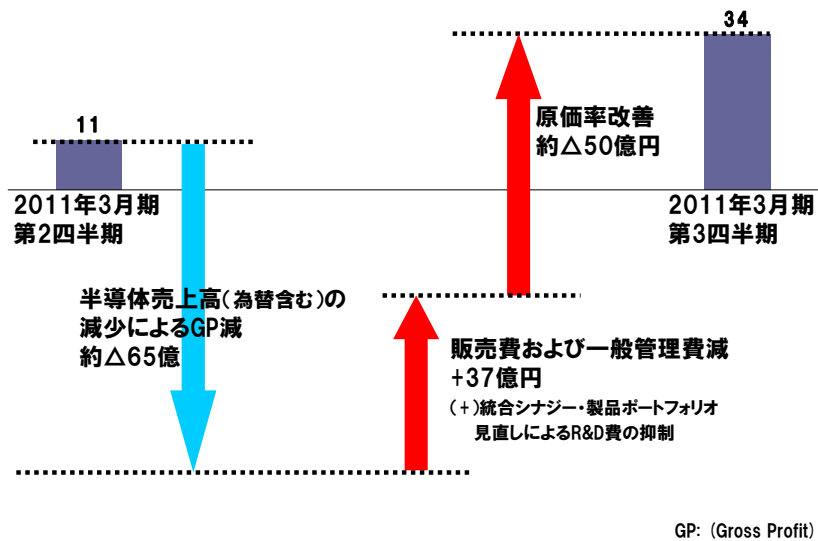
アナログ&パワー半導体は、市場の鈍化の影響を受け、パワー半導体、アナログIC、表示ドライバ、化合物デバイスなど、全ての分野で減収となりました。

SoCは、スマートフォンなどに搭載されるカメラLSIが好調だったものの、民生機器やPC周辺向けのシステムLSIなどが減収となりました。

2011年3月期 第3四半期営業損益(前四半期比)

■ 第3四半期の営業損益は、前四半期比で増益

(単位: 億円)



7 © 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

7ページは、第3四半期の営業損益を前四半期と比較したものです。

第3四半期の営業利益は、第2四半期と比較して23億円増益の34億円となりました。

第2四半期比で、半導体売上高が減少したものの、統合シナジーや製品ポートフォリオの見直しによる研究開発費の抑制、原価率の改善により、利益が改善いたしました。

バランスシート

(単位:億円)	10/4期首 (増資後)	10/9末	10/12末
総資産	12,154	11,627	11,513
うち 現金および現金同等物	3,377	3,318	3,343
うち たな卸資産	1,266	1,359	1,440
負債合計	8,017	7,992	8,084
うち 有利子負債	3,720	3,744	3,667
株主資本	4,210	3,798	3,622
純資産合計	4,136	3,635	3,429
D/Eレシオ(グロス)	0.91倍	1.05倍	1.09倍
D/Eレシオ(ネット)	0.08倍	0.12倍	0.09倍
自己資本比率	33.5%	30.7 %	29.2%

(注1)①現金および現金同等物:「現金および預金」と「有価証券」の単純合算値から「預入期間が3か月を超える定期預金」を控除しております。
 ②有利子負債:「短期借入金」、「1年内返済予定の長期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付社債」、「リース債務」、「新株予約権付社債」、「長期借入金」
 ③自己資本:「株主資本」、「評価・換算差額等」
 ④D/Eレシオ(グロス):有利子負債/自己資本
 ⑤10/4期首(増資後)の負債合計には、負ののれん22億円を便宜的に含めております。
 (注2)「10/4期首(増資後)」の数値は、当連結会計年度期首の数値に2010年4月1日付の企業結合に係る会計処理および同日付の第三者割当増資約1,346億円を反映した数値です。

8ページは、バランスシートでございます。

12月末のバランスシートにつきましては、有利子負債が9月末比で減少したことなどにより、ネットデットレシオは0.09倍となりました。

一方、当期純損失を計上した結果、株主資本が減少し、自己資本比率が29.2%となりました。

キャッシュ・フロー

(単位：億円)	2011年3月期			
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	9ヶ月累計
営業活動による キャッシュ・フロー	△20	350	539	869
投資活動による キャッシュ・フロー	△144	△184	△390	△718
フリー・ キャッシュ・フロー	△164	166	150	151

9ページは、キャッシュ・フローでございます。

第3四半期においては、ノキア社ワイヤレスモデム部門の買収に伴う支出があった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは改善し、フリー・キャッシュ・フローは150億円の黒字となりました。

Ⅱ. 2011年3月期 下期および通期業績見通し

次に2011年3月期 下期および通期業績の見通しについてご説明いたします。

2011年3月期 通期業績見通し

- 国内市場での需要回復が想定より弱く、売上高は下期および通期を下方修正。
- 営業利益は、統合シナジーの実現や原価低減により当初見込みから変更無し。

(単位:億円)	2011年3月期					
	上期実績	第3四半期実績	第4四半期見通し	下期見通し	年間見通し	前回発表比 (10/27)
売上高	5,875	2,752	2,873	5,625	11,500	△200
半導体売上高	5,250	2,444	2,606	5,050	10,300	△200
営業損益	7	34	29	63	70	-
経常損益	△78	11	17	28	△50	-
当期純損益	△412	△176	△212	△388	△800	-
1US\$=	90円	83円	82円			
1ユーロ=	116円	112円	110円			

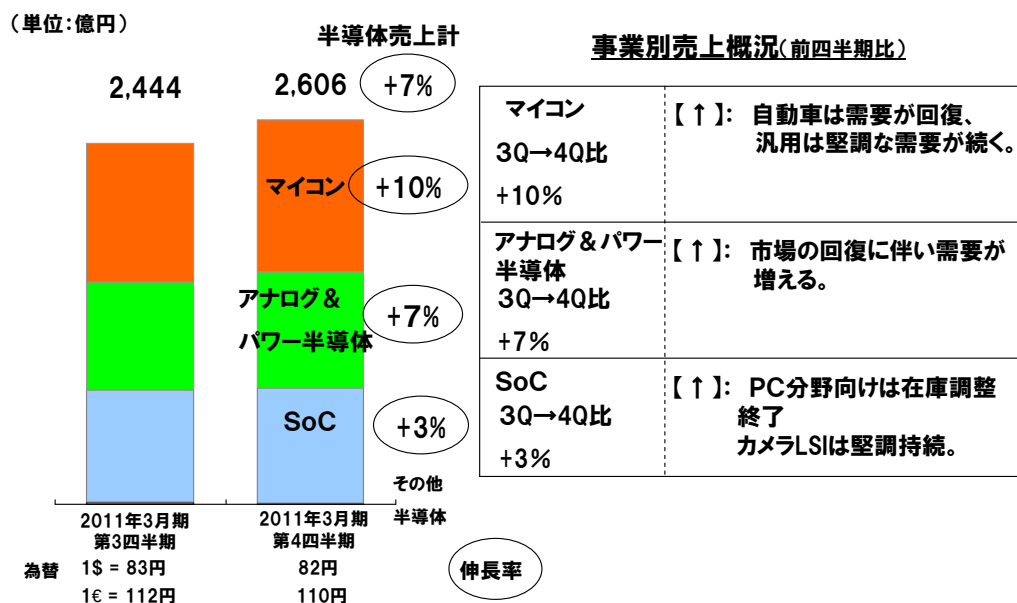
11ページは、2011年3月期 下期および通期の業績見通しでございます。

国内市場での需要回復が想定より弱いことなどにより、
通期の売上高見通しは1兆1,500億円とし、10月27日の見通しより200億円修正
いたしました。

営業損益、経常損益、当期損益につきましては前回の発表から変更しておりません。

下期半導体売上高の見通し

■ 第4四半期半導体売上高は、全製品群で増収



12 © 2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

RENESAS

12ページは下期の事業別の半導体売上高見通しについてお示ししています。

第4四半期の半導体売上高は、第3四半期比約7%増収の
2,606億円と想定しております。

事業別に見ますと、

マイコンは、自動車分野向けの需要が回復見込みであることと、汎用向けも堅調な需要が続く見通しから、第3四半期比で増収、

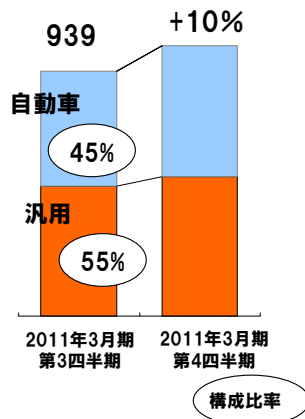
アナログ&パワー半導体は、第3四半期に減速した需要が回復見込みであることから、第3四半期比で増収

SoCは、パソコン関連市場の在庫調整が終了することや、スマートフォン向けカメラLSIが堅調であることなどにより、第3四半期比で増収となる見込みです。

マイコン事業 下期売上見通し

マイコン事業の内訳

(単位:億円)



第4四半期事業分野別見通し(前四半期比)

	市場動向	当社動向	
	第4四半期	第4四半期	
自動車分野			中国、新興国向けは引き続き好調。 国内向けは需要回復。
汎用分野			インバータ機器向けを中心に需要は 堅調の見込み。

まずマイコン事業の見通しを説明いたします。

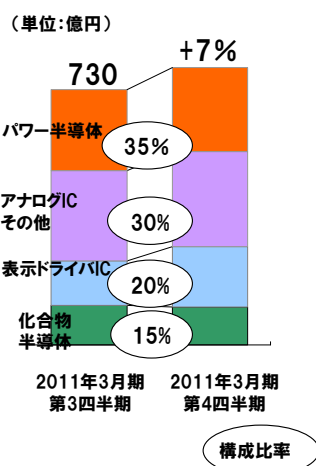
当社のマイコン事業の売上構成比は、自動車向けが約45%、汎用が約55%となっております。

自動車向けマイコンは、中国、新興国市場の自動車販売が引き続き好調であり、国内市場においても需要の回復が見込まれることから、第3四半期から第4四半期にかけて増収の見通しです。

汎用マイコンは、シェアの高いインバータ機器を中心に民生機器向けが堅調に推移すると見込んでおります。また、産業分野向けマイコンは引き続き需要好調であることから、第3四半期比で増収の見通しです。

アナログ&パワー半導体事業 下期売上見通し

アナログ&パワー半導体事業の内訳



第4四半期事業分野別見通し(前四半期比)

	市場動向	当社動向	
	第4四半期	第4四半期	
パワー半導体分野			民生・自動車分野向けで在庫調整が終了し、需要が回復。 PC分野向けは在庫調整が終了。
アナログIC分野			自動車向け(特に欧州)は引き続き堅調。 PC分野向けは在庫調整が終了。
表示ドライバIC分野			在庫調整が終了し、需要は回復。
化合物半導体分野			全般に需要は底打ち。

次にアナログ&パワー半導体事業の見通しについて説明いたします。

当社のアナログ&パワー半導体事業の売上構成比は、パワー半導体が約35%、アナログICその他が約30%、表示ドライバが約20%、化合物半導体が約15%となっております。

パワー半導体は、民生機器、自動車分野、パソコン周辺で汎用系部品在庫の調整が終了したことから、第3四半期から第4四半期にかけて増収の見通しです。

アナログICは、自動車分野、特に欧州市場が引き続き堅調であることや、パソコン周辺分野で部品在庫の調整が終了したことなどにより需要が回復、

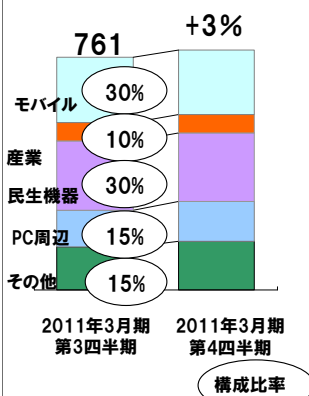
表示ドライバICは、市場の在庫調整が終了したことにより需要が回復する一方、化合物半導体は、全般的に需要が底打ちとなる見込みです。

SoC事業 下期売上見通し

第4四半期事業分野別見通し(前四半期比)

SoC事業の内訳

(単位:億円)



	市場動向	当社動向	
	第4四半期	第4四半期	
モバイル分野		➡	国内通信LSIの需要は減少。 カメラLSIはスマートフォン向け需要で堅調。
産業機器分野		➡	在庫の調整局面が継続し、需要停滞。
民生機器分野		➡	在庫調整が続き、全般的に需要停滞だが、STB(セットトップボックス)向けの需要が回復。
PC周辺分野		➡	PC分野向けは在庫調整が終了。 USB3.0向けの需要が好調。
その他	—	➡	ネットワーク向けメモリ需要回復。

次にSoC事業の見通しについて説明いたします。

当社のSoC事業の下期売上構成比は、携帯電話で約30%、産業機器で約10%、民生機器で約30%、PC周辺で約15%、その他約15%となっております。

モバイル分野は、国内通信LSIの需要は減少するものの、スマートフォン向けカメラLSIは引き続き堅調に推移する見込みであり、第3四半期から第4四半期にかけて横ばいの見通しです。

産業機器分野は、在庫調整の影響などにより需要は鈍化の見通し、

民生機器分野は、カスタム系部品の在庫調整が続き、全般的に需要は停滞となるものの当社においては、セットトップボックス向けの需要が回復する見込みです。

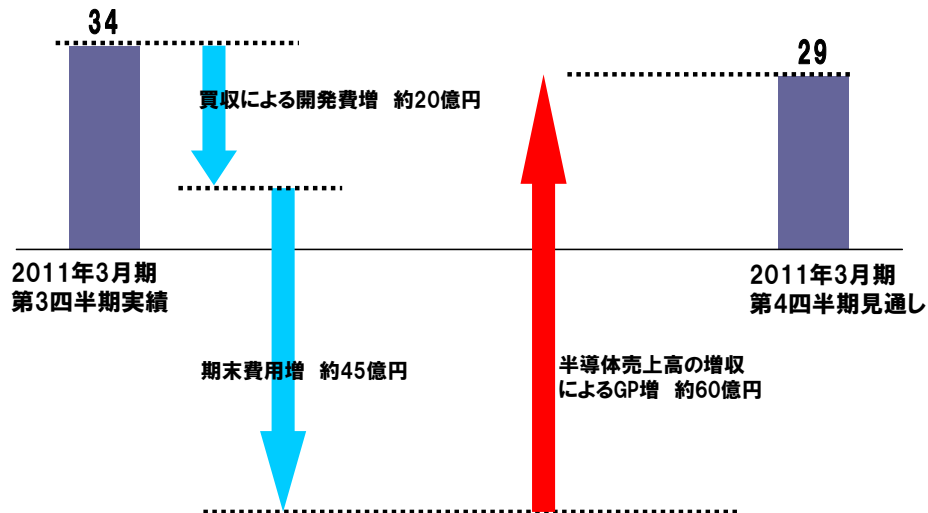
PC周辺分野は、在庫調整が終了したことやUSB3.0向けの需要が好調であることから、横ばいの見通しです。

その他には、ネットワーク機器用途やカーナビゲーション用途LSIが含まれます。

第4四半期に向けてはネットワーク向けメモリの需要が回復する見込みです。

2011年3月期 下期営業損益見通し(第3四半期、第4四半期)

(単位:億円)



16ページは、第4四半期の営業損益見通しを第3四半期と比較したものです。

第4四半期の営業利益は、
ノキア社ワイヤレスモデム部門の買収による研究開発費の増加や
期末費用の増加などがあるものの、
半導体売上高の増収により
29億円となる見通しです。

100日プロジェクト進捗状況

100日プロジェクトで策定した施策は計画通り実施中

	主要施策	進捗状況
人的効率化対策	◆早期退職プログラム	➢1/17～2/15募集期間にて 実施中
	◆販売特約店等出向他	➢販売関係 実施済み、他実施中
	◆注力事業への社内シフト	➢早期立ち上げに向け教育 実施中
	◆生産構造対策に伴う人的効率化	➢以下の計画通り 実施中 公表可能な段階にて開示予定
事業・生産構造対策	◆生産体制の最適化 (先端プロセス/ファブネットワーク)	➢鶴岡、ローズビル工場にて減損 実施済み ➢外部ファウンドリ含めて生産ライン間での 相互乗り入れ 実施中
	◆生産工場の再編	➢滋賀(5インチ)、高知(2階)、福岡など生産ラインの 再編を計画通り 実施中
統合シナジーの実現	◆販売効率の向上	➢特約店商流の整理(30社⇒16社) 実施済み ➢販売拠点の統廃合 国内17→6拠点へ 実施済み 。(本社除く) 海外21→10拠点へ 実施済み
	◆他各種施策	➢製品の統合、設計技術力の向上、生産効率の改善 等、計画通り 実施中

事業ポートフォリオの最適化に向けた各種施策についても計画通り**実施中**

2011年3月期業績予想に織り込んでいる特別損失770億円については変更無し

100日プロジェクトの進捗状況でございます。

まず、人的効率化対策の進捗です。

早期退職プログラムにつきましては、1月17日から2月15日を募集期間とし、現在実施中
でございます。

販売特約店等への出向は実施済み、

注力事業への社内シフトにおいては、早期立ち上げに向けて、教育を実施中でございます。

生産構造対策に伴う人的効率化といたしましては、事業・生産構造対策に伴い、計画通り実施中
でございます。内容につきましては、公表可能な段階にて順次ご報告いたします。

事業・生産構造対策においては、生産対策の最適化に向けて、

鶴岡工場、ローズビル工場の減損を第1四半期に実施した他、

外部ファウンドリを含めた生産ライン間での相互乗り入れを実施中でございます。

生産工場の再編においては、滋賀、高知、福岡などの生産ライン再編を

計画通り着実に進めております。

また、統合シナジーの実現として、特約店商流の再編や国内外の販売拠点の統廃合を実施し、販売
効率の向上を進めています。

ほか各種施策につきましても計画通り実施中でございます。

事業ポートフォリオの最適化に向けた各種施策についても、計画通り実施中でございます。

なお、2011年3月期業績予想に織り込んでいる特別損失770億円につきまして、変更は
いたしません。

ござ

まとめ

- **第4四半期売上高については、第3四半期比で増収の見通し。**
- **通期で70億円の営業利益の達成を目指す。**
- **100日プロジェクトで策定した構造対策プランは、計画通り進捗中。**

最後に本日のまとめでございます。

まず第4四半期売上高につきましては、第3四半期比で増収の見通しでございます。

そして、当初計画通り、通期で70億円の営業利益の達成を目指します。

100日プロジェクトで策定した構造対策プランは着実に実施しています。

今後も、強固な経営基盤の構築に向けて、計画通り、施策の実行を進めていきます。



2011年3月期第3四半期の決算概要のご説明は以上でございます。
本日は有難うございました。